

☆SiP、WLP、FOWLP、TSV技術、最新の3Dパッケージなどを解説！

半導体パッケージの作製プロセスと その課題および最新技術動向

1名分料金で
2人目無料◆日時：【LIVE受講】2026年7月10日（金） 13:00～17:00
【アーカイブ受講】2026年7月14日（火）～7月21日（火）

◆形式：ZoomによるWEB配信

◆聴講料：1名につき49,500円（税込、資料付）

※会員登録（無料）をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

・1名でお申込みされた場合、1名につき**38,500円（税込）**・2名以上同時でお申し込みされた場合、1名につき**24,750円（税込）**★HPはこちらから ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/260700>

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

◆講師：サクセスインターナショナル（株） 代表取締役 池永 和夫 氏

【受講対象】

パッケージ技術に関する若手技術者、装置メーカー、材料メーカーの技術者、および営業、マーケティング担当者など。

【習得できる知識】

様々なパッケージ技術の変遷とその要素技術に関する知識が得られる。それにより、パッケージの形状、工程等の意味と関連性を深く理解が出来るようになり、将来のパッケージ開発、材料・装置開発などに役立てることが出来る。また、最新のパッケージ技術の動向を把握することができる。

【講座の趣旨】

パッケージに求められる機能および、パッケージの種類と変遷について解説する。また、パッケージ作製の工程を説明しその課題について解説する。さらに最近のパッケージの動向としてSiP、WLP、FOWLP、TSV技術、最新の3Dパッケージなどを例に解説する。

※職場や自宅のPCでオンライン会議アプリZoomを使って受講できます。受講方法は申込後にご連絡いたします。

【プログラム】

- 半導体パッケージとは
 - 1-1. パッケージに求められる機能
 - 1-2. パッケージ構造と変遷
 - 1-3. パッケージの種類
 - 1-4. 実装技術の変遷とパッケージとの関連
- パッケージの組み立て工程（後工程）と課題
 - 2-1. バックグランド工程
 - 2-2. ダイシング工程
 - 2-3. ダイボンディング工程
 - 2-4. ワイヤボンディング工程
 - 2-5. モールド封止工程
 - 2-6. バリ取り・端子めっき工程
 - 2-7. トリム&フォーミング工程
 - 2-8. マーキング工程
 - 2-9. 測定工程
 - 2-10. 梱包工程
- パッケージの技術動向
 - 3-1. パッケージの電気特性と多ピンパッケージ
 - 3-2. フリップチップ ボンディング
 - 3-3. SiP
 - 3-4. WLP
 - 3-5. FOWLP
 - 3-6. TSV
 - 3-7. 最新3Dパッケージ
- まとめ

≪ 質疑応答 ≫

『半導体パッケージ』セミナー申込書 ※ご希望の受講形式どちらかにチェックを入れて下さい⇒ LIVE アーカイブ

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録（無料） ※案内方法を選択してください。複数選択可。

 Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

左記の欄に必要な事項をご明記の上、FAXでご送付ください。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたしまして、受講券・請求書をお送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>